

MAXDATA PLATINUM 300 IR

Podręcznik użytkownika

Spis treści

1 Konfigurowanie systemu	5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
Miejsce serwera	5
Ostrzeżenia dotyczące dostępu do systemu	6
Ostrzeżenia dotyczące montażu w szafie	6
Włączanie zasilania systemu	7
2 Funkcje serwera	9
Położenia złączy oraz gniazd	10
Zworki konfiguracyjne	11
Złącza tylnego panelu	12
Wymagania sprzętowe	13
Procesor	13
Pamięć	13
3 Montaż podzespołów i aktualizacji	15
Przed rozpoczęciem	15
Wymagane narzędzia i materiały	15
Zakładanie i wyjmowanie kart pamięci	15
Instalowanie pamięci DIMM	15
Wymiana baterii awaryjnej	17
4 Narzędzia serwera	19
Konfiguracja pamięci BIOS	19
Uruchomienie opcji konfiguracji	19
W przypadku niemożności wejścia do opcji konfiguracyjnych	19
Menu konfiguracji	19
Wyzerowanie pamięci CMOS	21
Konfigurowanie systemu na potrzeby szeregowej magistrali RAID ATA	22
Konfigurowanie systemu BIOS	22
Tworzenie zbioru RAID Intel® Matrix Storage Technology	22
Tworzenie własnego zestawu RAID LSI Technology	22
Ładowanie sterowników RAID	23
5 Informacje prawne i dotyczące zgodności	25
Zgodność prawna produktu	25
Zgodność produktu w zakresie bezpieczeństwa	25
Zgodność produktu z dyrektywą RoHS	25
Kompatybilność elektromagnetyczna produktu	25
Oznaczenia zgodności prawnej produktu	25
Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej	25
Europa (Deklaracja zgodności CE)	25

Rysunki

1. Widok z przodu.....	7
2. Lokacje złącz oraz podzespołów.....	10
3. Położenie zworek konfiguracyjnych.....	11
4. Złącza na tylnym panelu	12
5. Instalowanie pamięci DIMM	15
6. Wyjmowanie baterii.....	18

Tabela

1. Podsumowanie funkcji	9
2. Złącza oraz podzespoły płyty serwerowej	10
3. Zworki konfiguracyjne	11
4. Złącza na tylnym panelu	12
5. Diody LED złącz NIC.....	12
6. Polecenia wydawane z klawiatury.....	20
7. Oznaczenia świadectw zgodności produktu.....	25

1 Konfigurowanie systemu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Miejsce serwera

Przy konfigurowaniu komputera należy wziąć pod uwagę następujące kryteria tworzenia praktycznego i bezpiecznego miejsca pracy:

OSTRZEŻENIE

System można stosować w każdym pomieszczeniu, gdzie temperatura jest odpowiednia dla ludzi. Jednakże nie są odpowiednie pomieszczenia o wilgotności przekraczającej 70 % oraz obszary brudne i zakurzone. Ponadto, nie wolno wystawiać serwera na działanie temperatur wyższych niż +30 °C lub niższych od +10 °C.

OSTRZEŻENIE

W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia i przepływu powietrza, system może być włączony tylko przy założonych pokrywach obudowy.

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że przewody łączące serwer z urządzeniami peryferyjnymi nie zostały zaciśnięte.

OSTRZEŻENIE

Należy sprawdzić czy wszystkie przewody zasilające i łączące zostały rozłożone w pozycji nie powodującej zagrożenia potknięciem.

OSTRZEŻENIE

Przy zapisywaniu danych na twardym dysku serwera lub na dyskietce, zostają one zapisane w postaci informacji magnetycznych na nośniku. Należy upewnić się, że nie zostaną one uszkodzone lub zniszczone przez pola elektromagnetyczne.

OSTRZEŻENIE

Ponieważ elementy elektroniczne komputera mogą zostać uszkodzone przez wstrząsy, nie wolno umieszczać żadnych urządzeń mechanicznych na tej samej powierzchni co serwer. Ma to szczególne znaczenie w przypadku drukarek uderzeniowych, których wibracje mogłyby spowodować uszkodzenie twardego dysku.

OSTRZEŻENIE

Stany, urządzenia oraz przewody stwarzające zagrożenia: Przewody zasilające, telefoniczne i komunikacyjne mogą stwarzać stany zagrożenia elektrycznego. Przed otwarciem obudowy serwera należy wyłączyć serwer i odłączyć przewód zasilający, systemy telekomunikacyjne, sieciowe i modemy przyłączone do serwera. W przeciwnym wypadku może nastąpić uraz ciała lub uszkodzenie sprzętu.

OSTRZEŻENIE

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) oraz ochrona przed ESD: ESD mogą uszkadzać stacje dysków, płyty rozszerzeń oraz inne podzespoły. Zaleca się wykonywanie wszystkich procedur z rozdziału 3 wyłącznie na stacji roboczej ESD. Jeżeli takowa stacja nie jest dostępna, należy zapewnić pewien stopień ochrony przed ESD przez noszenie antyelektrostatycznej opaski na nadgarstku przyłączonej do uziemienia obudowy – dowolnej niemalowanej powierzchni metalowej – serwera przy dotykaniu podzespołów.

UWAGA

W celu pełnego odłączenia serwera od prądu należy odłączyć przewód zasilający od ściennego gniazdka sieciowego

Ostrzeżenia dotyczące dostępu do systemu



OSTRZEŻENIE

Przy otwieraniu produktu należy zawsze stosować się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa w celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu:

- Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do produktu.
- Wyłączyć system przez wciśnięcie przycisku zasilania.
- Odłączyć zasilanie, przez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od systemu lub gniazdek ściennych.
- Odłączyć wszystkie przewody i linie telekomunikacyjny podłączone do systemu.
- Przy zdejmowaniu pokryw dostępowych należy zachować wszystkie śrubki i inne elementy mocujące. Po zakończeniu prac wewnątrz produktu, należy ponownie przymocować pokrywę dostępową przy pomocy oryginalnych śrubek lub elementów mocujących.
- Nie wolno otwierać zasilacza. Nie zawiera on części, które użytkownik może konserwować samodzielnie. W celu dokonania napraw należy zwrócić zasilacz do producenta.
- Wyłączyć zasilanie serwera i odłączyć wszystkie przewody zasilające przed dodaniem lub wymianą podzespołów podłączanych przy wyłączonym serwerze.
- Przy wymianie zasilacza podłączanego w trakcie pracy, należy odłączyć przewód zasilający od wymienianego zasilacza przed fizycznym usunięciem go z serwera.



OSTRZEŻENIE

Jeżeli serwer był uruchomiony, zamontowane procesory i radiatory są najprawdopodobniej gorące. Przed zdjęciem pokryw należy odczekać do ochłodzenia systemu, chyba że dodawany / wyjmowany podzespół należy do elementów podłączanych w trakcie pracy. W trakcie instalacji/wyjmowania elementów podłączanych w trakcie pracy należy uważać, aby nie dotknąć gorących podzespołów.



OSTRZEŻENIE

W celu uniknięcia urazu należy uważać na ruchome łopatki wentylatora. Jeżeli system wyposażono w osłonę wentylatora, nie wolno używać systemu bez założonej osłony.

Ostrzeżenia dotyczące montażu w szafie

Szafa na sprzęt musi być zamocowana do nieruchomego wspornika, żeby nie wywracała się przy wysuwaniu serwera lub elementu sprzętowego. Szafa na sprzęt musi zostać zamontowana zgodnie z instrukcjami producenta szafy.

Sprzęt należy montować w szafie rozpoczynając od góry, z najcięższym sprzętem umieszczonym na dole szafy.

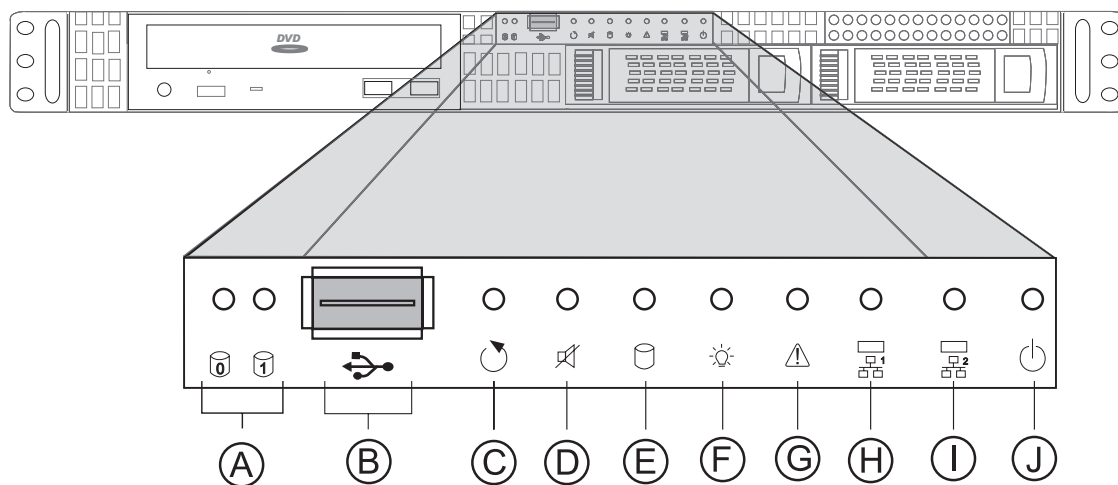
Na raz można wysuwać z szafy tylko jeden element sprzętowy.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zamontowanie wyłącznika głównego zasilania dla całej szafy. Wyłącznik głównego zasilania musi być łatwo dostępny oraz oznaczony, że steruje zasilaniem całego zespołu urządzeń, a nie tylko serwera (serwerów).

Szafa i każdy element sprzętowy w niej zamontowany musi posiadać odpowiednie uziemienie, w celu uniknięcia ryzyka potencjalnego porażenia prądem.

Włączanie zasilania systemu

Z przodu obudowy znajdują się niezbędne elementy sterujące, jak np. przycisk zasilania, przycisk resetujący oraz diody LED twardego dysku (HDD). W celu włączenia serwera należy raz krótko wcisnąć przycisk zasilania.



Rysunek 1. Widok z przodu

- | | |
|---|---|
| A. Diody LED aktywności kieszeni twardego dysku | F. Dioda LED zasilania |
| B. Port USB 2.0 | G. Dioda LED awarii |
| C. Przycisk resetowania | H. Dioda LED aktywności złącza NIC 1 |
| D. Przycisk wyciszania alarmu wentylatora | I. Dioda LED aktywności złącza NIC 2 (nieużywane w tym systemie) |
| E. Diody LED aktywności systemowego twardego dysku | J. Przycisk zasilania |

2 Funkcje serwera

Niniejszy rozdział pokrótce opisuje główne funkcje serwera.

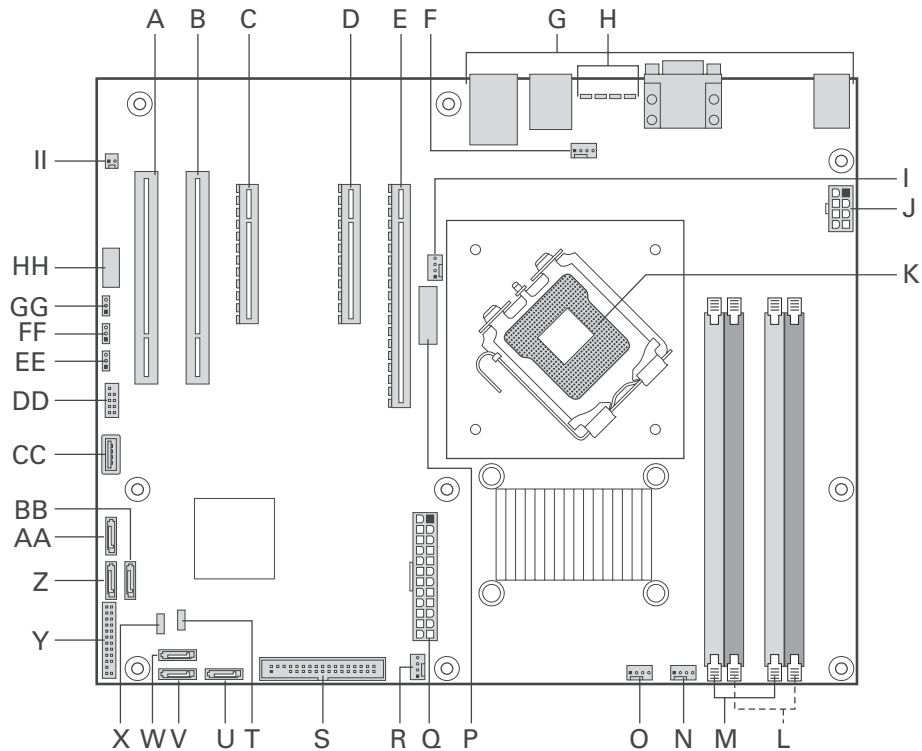
Tabela 1 podsumowuje główne funkcje płyty głównej.

Tabela 1. Podsumowanie funkcji

Funkcja	Opis
Wymiary obudowy	43,5 mm (wysokość) 430 mm (szerokość) 569 mm (głębokość) Maksymalna waga obudowy: 17 kg
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Obsługa procesora dwurdzeniowego Intel® Xeon® serii 3000 i czterordzeniowego Intel® Xeon® serii 3200• Obsługa technologii Intel® Extended Memory System 64Technology (EM64T)
Pamięć	Cztery gniazda DIMM do zainstalowania wielowarstwowych pamięci DDR2 667/800 MHz (maks. 8 GB pamięci systemowej) bez buforów, spełniających warunki ECC i niespełniających tych warunków
Chipset	Chipset Intel® 3200, składający się z: <ul style="list-style-type: none">• koncentratora kontrolera pamięci Intel® 3200/3210 (MCH),• koncentratora kontrolera WE/WY Intel® (ICH9R),• koncentratora PXH-V PCI-X Intel® 6702.
Interfejsy urządzeń peryferyjnych	Układ WE/WY Super I/O Winbond 8374LF2 Złącza zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none">• Wielowarstwowe porty PS2 klawiatury i myszy• Port szeregowy DB9• Dwa porty sieciowe RJ45 NIC 10/100/1000 Mb/s• Dwa porty USB 2.0 Złącza wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none">• Jedno dodatkowe wewnętrzne gniazdo USB obsługujące dwa porty USB 2.0• Jedno gniazdo portu szeregowego B DH10• Sześć gniazd SATA (3 Gb/s) ze zintegrowaną obsługą macierzy RAID• 24-pinowe dodatkowe wewnętrzne gniazdo panelu kontrolnego zgodne ze standardem ATX
Wideo	Zintegrowana karta wideo iBMC Server Engine na płycie zewnętrzna pamięć wideo o pojemności 32 MB
LAN	<ul style="list-style-type: none">• Karta Intel® 10/100/1000 82566E Gigabit Ethernet• Karta Intel® 10/100/1000 82541PI Gigabit Ethernet
Możliwości rozbudowy	<ul style="list-style-type: none">• Jedno złącze x8 PCI-Express na pełnowymiarowej karcie pomocniczej
Wentylatory	Obsługa dwóch wentylatorów systemowych i jednego wentylatora procesora
Zarządzanie systemem	Intel® System Management Software

Położenia złącz oraz gniazd

Rysunek 2 pokazuje przybliżone położenie głównych elementów na płycie głównej.



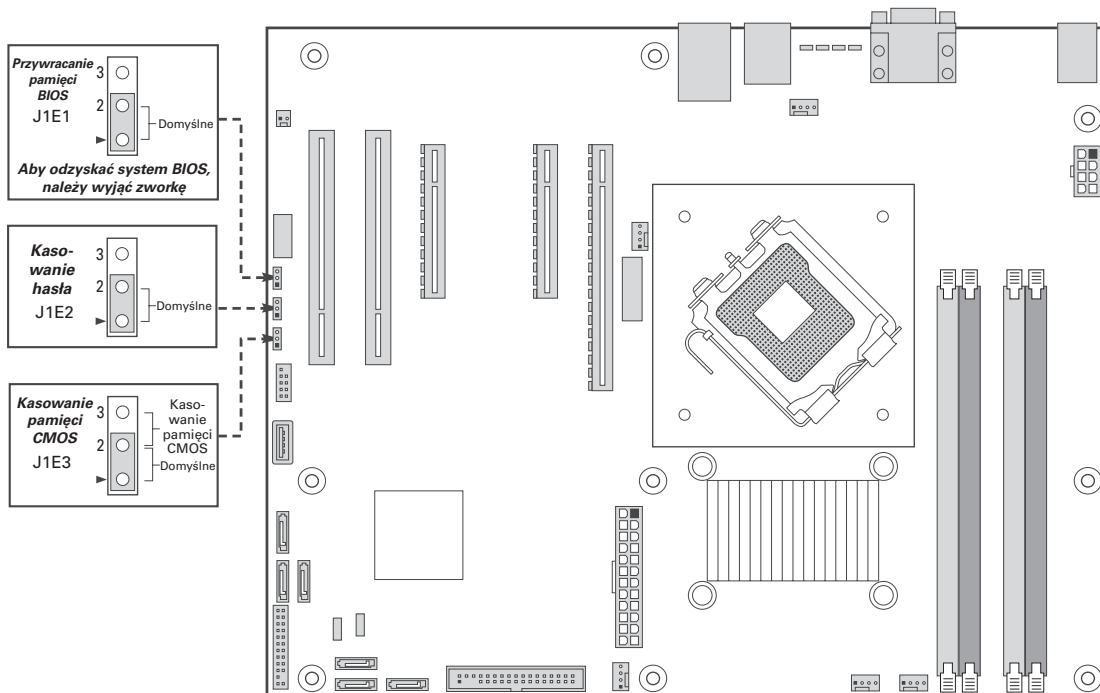
Rysunek 2. Lokacje złącz oraz podzespołów

Tabela 2. Złącza oraz podzespoły płyty serwerowej

Etykieta	Opis	Etykieta	Opis
A.	Gniazdo PCI 1 (5 V/32 bity/33 MHz)	S.	Złącze stacji dyskieta
B.	Gniazdo PCI 2 (5 V/32 bity/33 MHz)	T.	HSBP
C.	PCI Express x8	U.	SATA 0
D.	PCI Express x8	V.	SATA1
E.	Złącze x16 PCI Express	W.	SATA 2
F.	Gniazdo wentylatora systemowego 1	X.	IPMB
G.	Złącza tylnego panelu	Y.	Gniazdo panelu przedniego
H.	Diagnostyczne diody LED	Z.	SATA 4
I.	Gniazdo wentylatora procesora 1	AA.	SATA 5
J.	Złącze zasilania dodatkowego 2x4	BB.	SATA 3
K.	Gniazdo procesora	CC.	Wewnętrzne gniazdo USB
L.	Gniazda DIMM, kanał 2	DD.	Zewnętrzne gniazdo USB
M.	Gniazda DIMM, kanał 1	EE.	Zworka kasowania pamięci CMOS
N.	Gniazdo wentylatora systemowego 4	FF.	Zworka kasowania hasła
O.	Gniazdo wentylatora systemowego 3	GG.	Zworka odzyskiwania systemu BIOS
P.	Baterie	HH.	Port szeregowy
Q.	Złącze głównego zasilania	II.	Gniazdo alarmu otwarcia obudowy
R.	Gniazdo wentylatora systemowego 2		

Zworki konfiguracyjne

Rysunek 3 przedstawia położenie zwrotek konfiguracyjnych.

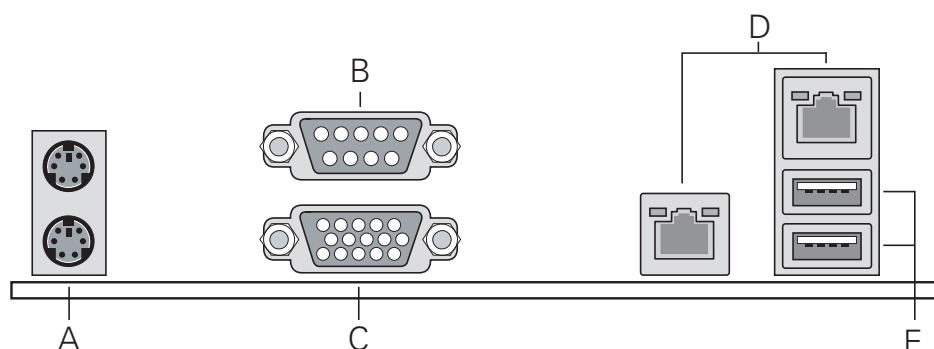


Rysunek 3. Położenie zwrotek konfiguracyjnych

Tabela 3. Zworki konfiguracyjne

Nazwa zworki	Funkcja
Odzyskiwanie systemu BIOS	<ul style="list-style-type: none"> Styki 1-2: Praca standardowa. Zworka wyjęta: Odzyskanie systemu BIOS w wypadku uszkodzenia systemu. Wymagany nośnik rozruchowy z prawidłową pamięcią ROM systemu BIOS.
Kasowanie hasła	<ul style="list-style-type: none"> Styki 1-2: Praca standardowa, ochrona hasłem Styki 2-3: Wymazywanie hasła: po założeniu zworki na te styki na 5–10 sekund przy następnym zresetowaniu serwera hasło zostanie wyzerowane. W przypadku normalnej eksploatacji zworka nie powinna być umieszczona na tych stykach. <p>UWAGA Aby wykasować hasło, nie trzeba resetować serwera poprzez zakładanie tych zwrotek na wymienione styki. Aby wykasować hasło za pomocą tej zworki: Wyłącz serwer. Załóż zworkę na styki 2–3 na 5–10 sekund. Przełóż zworkę z powrotem na styki 1–2. Włącz serwer.</p>
Kasowanie pamięci CMOS	<ul style="list-style-type: none"> Styki 1-2: Praca standardowa. Styki 2-3: Wymazywanie pamięci CMOS: po założeniu zworki na te styki na 5–10 sekund przy następnym zresetowaniu systemu zostaną wykasowane ustawienia pamięci CMOS. W przypadku normalnej eksploatacji zworka nie powinna być umieszczona na tych stykach. <p>UWAGA Aby wykasować pamięć CMOS, nie trzeba resetować serwera poprzez zakładanie zworki na wymienione styki. Aby wykasować pamięć CMOS: Wyłącz serwer. Załóż zworkę na styki 2–3 na 5–10 sekund. Przełóż zworkę z powrotem na styki 1–2. Włącz serwer.</p>

Złącza tylnego panelu



Rysunek 4. Złącza na tylnym panelu

Tabela 4. Złącza na tylnym panelu

Etykieta	Opis	Etykieta	Opis
A.	Piętrowo zestawione porty klawiatury/myszy PS2	D.	Złącze NIC 1/2 (10/100/1000 Mb/s)
B.	Złącze szeregowe A	E.	USB1-2
C.	Wideo		

Diody LED złącza NIC umieszczone po prawej i lewej stronie każdego złącza NIC dostarczają poniższych informacji.

Tabela 5. Diody LED złącz NIC

Dioda LED	Stan diody LED	Opis
Prawa	Wyłączona	Brak połączenia sieciowego
	Stały zielony	Nawiązano połączenie sieciowe
	Migająca zieleń	Aktywność przesyłania / odbierania
Lewa	Wyłączona	Połączenie z prędkością 10 Mb/s (jeżeli lewa dioda LED jest włączona lub miga)
	Stały zielony	Połączenie o prędkości 100 Mb/s
	Stały bursztynowy	Połączenie o prędkości 1000 Mb/s

Wymagania sprzętowe

Żeby uniknąć problemów z integracją oraz ewentualnych uszkodzeń płyty, Państwa system musi spełniać niżej wymienione wymagania.

Procesor

Obsługa procesora dwurdzeniowego Intel® Xeon® serii 3000 i czterordzeniowego Intel® Xeon® serii 3200.

Pamięć

Na płycie serwera znajdują się cztery gniazda pamięci DIMM, podzielone na dwa banki. Gniazda DIMM A1 i B1 należą do banku 1. Gniazda DIMM A2 i B2 należą do banku 2. Moduł minimalny, jaki można zainstalować, to jeden układ DIMM o pojemności 512 MB w gnieździe A1. Obsługuje on przeplatanie jednokanałowe. W przypadku przeplatania dwukanałowego w gniazdach A1 i B1 muszą znajdować się dwa takie same układy DIMM.

Żeby pracować w trybie dynamicznego stronicowania dwukanałowego muszą zostać spełnione następujące warunki:

- Zapęłnić gniazda DIMM A1 i DIMM B1 dwiema identycznymi kostkami pamięci.
- W każdym z czterech gniazd muszą być takie same kości pamięci.

Uwaga:

Nie można używać trzech kości pamięci. Należy używać kości DIMM, które są identyczne (taki sam typ i prędkość). Preferuje się używanie identycznych modułów pamięci DIMM.

Karty pamięci DIMM muszą spełniać następujące wymagania:

- Należy korzystać wyłącznie z kart pamięci DIMM z technologią DDR2 DRAM.
- Należy używać tylko zestawionych modułów DIMM DDR2-667 i DDR2-800.

3 Montaż podzespołów i aktualizacji

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem pracy z niniejszym produktem należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na początku niniejszego podręcznika.

Wymagane narzędzia i materiały

- Śrubokręt krzyżakowy (nr 1 i nr 2)
- Kombinierki z igłowymi noskami
- Antyelektrostatyczna opaska na nadgarstek oraz przewodząca podkładka gąbkowa (zalecane)

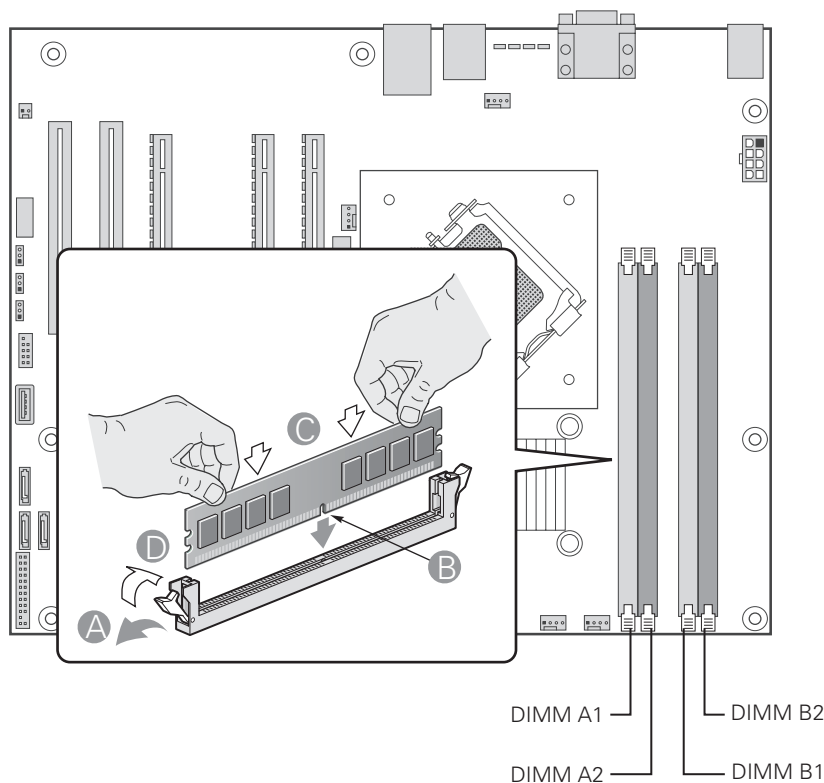
Zakładanie i wyjmowanie kart pamięci

Poniższa ilustracja pokazuje gniazda DIMM na płycie głównej: od środka płyty są to DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1, DIMM B2. DIMM A1 jest gniazdem umieszczonym najbliżej gniazda procesora.

Instalowanie pamięci DIMM

W celu zainstalowania pamięci DIMM, należy wykonać poniższe czynności:

1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności związanych z ładunkami elektrostatycznymi zamieszczonych w rozdziale „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć obudowę serwera.
5. Zlokalizować gniazda DIMM (rys. 5).



Rysunek 5. Instalowanie pamięci DIMM

6. Upewnić się, że zaciski na obydwu końcach gniazd(a) DIMM zostały rozwarte do pozycji „otwarte” (litera A na rys. 5).
7. Trzymając kartę za krawędzie, wyjąć ją z opakowania antyelektrostatycznego.
8. Umieścić kartę DIMM nad gniazdem. Ustawić w jednej linii małe nacięcie w dolnej krawędzi modułu DIMM z wpustem gniazda (zob. litera B na rys. 5).
9. Włożyć dolną krawędź modułu DIMM do gniazda (zob. litera C na rys. 5).
10. Po włożeniu karty DIMM, dopchnąć górną krawędź do momentu zatrzaśnięcia zacisków utrzymujących. Upewnić się, że zaciski zostały dokładnie zamknięte (zob. litera D na rys. 5).
11. Ponownie założyć obudowę serwera i podłączyć przewód zasilający.

Wymiana baterii awaryjnej

Litowa bateria płyty serwerowej zasila układ RTC przez okres do 10 lat przy braku zasilania sieciowego. Kiedy bateria zacznie się rozładowywać, traci napięcie a ustawienia serwera przechowywane w pamięci CMOS RAM w układzie RTC (na przykład data i czas) mogą być nieprawidłowe. Prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem biura obsługi klienta lub z dealerem w celu uzyskania listy zaaprobowanych urządzeń.



OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją. Wymieniać tylko na taki sam lub równoważny typ, zalecany przez producenta. Zużyte baterie utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



WARNING

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.



WARNUNG

Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement par une pile du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.



ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.



VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

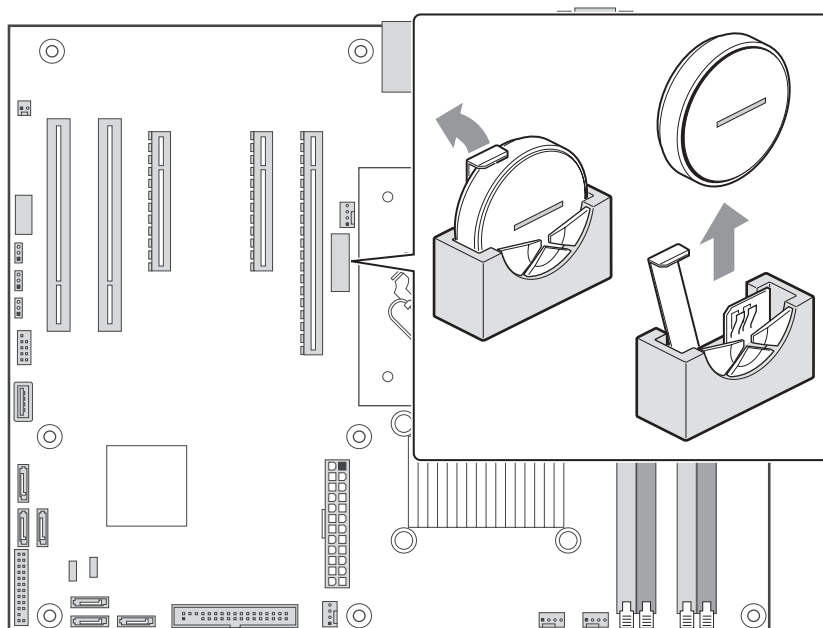


VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

W celu wyjęcia baterii należy wykonać poniższe czynności:

1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności związanych z ładunkami elektrostatycznymi zamieszczonych w rozdziale „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć obudowę serwera i znaleźć baterię.
5. Unieść mechanizm blokujący baterii (zob. rys. 6).
6. Wyjąć baterię z jej gniazda.



Rysunek 6. Wyjmowanie baterii

7. Baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami.
8. Wyjąć nową baterię litową z opakowania i włożyć ją w gniazdo baterii, upewniając się, że zostaje zachowana prawidłowa biegunowość.
9. Zamknąć obudowę.
10. Uruchomić program Setup w celu przywrócenia ustawień konfiguracyjnych do układu RTC.

4 Narzędzia serwera

Konfiguracja pamięci BIOS

Niniejszy rozdział opisuje narzędzia zawarte w opcjach konfiguracji pamięci BIOS, używane do zmiany domyślnej konfiguracji serwera. Konfigurację pamięci BIOS można uruchamiać z systemem operacyjnym lub bez systemu operacyjnego.

Uruchomienie opcji konfiguracji

Istnieje kilka warunków, w jakich można wejść do opcji konfiguracji BIOS-u i ją rozpocząć:

- Kiedy zostanie włączony serwer, po zakończeniu testu pamięci POST
- Kiedy zworka konfiguracyjna CMOS na płycie serwera został przesunięta w położenie "Clear CMOS" (włączone).

Po spełnieniu tych warunków podczas autotestu wykonywanego w trakcie ponownego uruchamiania komputera pojawi się następujący monit:

```
Press <F2> to enter SETUP (Naciśnij klawisz F2, aby uruchomić
program konfiguracyjny)
```

Po spełnieniu trzeciego warunku, to znaczy po wystąpieniu błędu CMOS/NVRAM, pojawią się inne monity systemu, lecz nie zgłoszenie z warunkiem <F2>:

```
Warning: CMOS checksum invalid (Ostrzeżenie: nieprawidłowa suma
kontrolna CMOS)
```

```
Warning: CMOS time and date not set (Ostrzeżenie: nie ustawiono
godziny i daty CMOS)
```

Przy tym warunku, BIOS załaduje wartości domyślne pamięci CMOS i podejmie próbę restartu komputera.

W przypadku niemożności wejścia do opcji konfiguracyjnych

Jeżeli nie można uzyskać dostępu do konfiguracji pamięci BIOS, może zaistnieć konieczność wyzerowania pamięci CMOS. Instrukcje dotyczące zerowania pamięci CMOS – zobacz: "Wyzerowanie pamięci CMOS".

Menu konfiguracji

Każda strona z opcjami konfiguracji BIOS-u zawiera pewną liczbę funkcji. Za wyjątkiem tych funkcji, które wyświetlają tylko informacje skonfigurowane automatycznie, każda funkcja jest skojarzona z polem wartości, które zawiera parametry wybierane przez użytkownika. Posiadając uprawnienia, użytkownik może zmieniać te parametry. Jeżeli wartości nie można zmienić z jakiegoś powodu, pole wartości funkcji jest niedostępne.

Tabela 6 zawiera opis poleceń klawiaturowych, używanych w menu konfiguracji pamięci BIOS.

Tabela 6. Polecenia wydawane z klawiatury

Wcisnąć	Opis
<F1>	Pomoc – Wciśnięcie klawisza F1 w dowolnym menu powoduje przywołanie okna ogólnej pomocy.
← →	Klawisze strzałek w lewo i w prawo są używane do przechodzenia pomiędzy stronami głównego menu. Klawisze te nie mają żadnego efektu, jeżeli wyświetlono podmenu lub listę wyboru.
↑	Wybierz pozycję z góry – Strzałka w górę jest używana do wybrania poprzedniej wartości z listy opcji pozycji menu lub listę wyboru pół wartości. Wciśnięcie klawisza Enter aktywuje wybraną pozycję.
↓	Wybierz pozycję z dołu – Strzałka w dół jest używana do wybrania następnej wartości z listy opcji pozycji menu lub listę wyboru pół wartości. Wciśnięcie klawisza Enter aktywuje wybraną pozycję.
F5/-	Zmień wartość – Znak minus lub klawisz funkcyjny F5 jest używany do zmiany wartości bieżącej pozycji na wartość poprzednią. Ten klawisz powoduje przewinięcie przez wartości w skojarzonej liście wyboru bez wyświetlania całej listy.
F6/+	Zmień wartość – Znak plus lub klawisz funkcyjny F6 jest używany do zmiany wartości bieżącej pozycji menu na wartość następną. Ten klawisz powoduje przewinięcie przez wartości w skojarzonej liście wyboru bez wyświetlania całej listy. W przypadku 106-klawiszowej klawiatury japońskiej, klawisz plus posiada inny kod skanowania od klawisza plus na pozostałych klawiaturach, lecz jego wciśnięcie ma taki sam efekt.
<Enter>	Wykonaj polecenie – Klawisz Enter jest używany w celu aktywacji podmenu, kiedy wybrana funkcja jest submenu lub w celu wyświetlenia listy wyboru, jeżeli wybrana funkcja posiada pole wartości, lub w celu wybrania pod-pola dla funkcji z wieloma wartościami jak czas i data. Jeżeli jest wyświetlona lista wyboru, klawisz Enter spowoduje cofnięcie listy wyboru i pozwoli na dokonanie innego wyboru w menu macierzystym.
<Esc>	Wyjdź – Klawisz ESC zapewnia możliwość wycofania się z dowolnego pola. Ten klawisz cofa efekty wciśnięcia klawisza Enter. Kiedy klawisz ESC zostaje wciśnięty przy edycji dowolnego pola lub przy wyborze funkcji menu, zostaje ponownie wyświetlone menu macierzyste. Kiedy klawisz ESC zostaje wciśnięty w dowolnym submenu, zostaje ponownie wyświetlone menu macierzyste. Kiedy klawisz ESC zostaje wyświetlony w dowolnym głównym menu, zostaje wyświetlone okienko potwierdzenia wyjścia z zapytaniem czy użytkownik chce odrzucić dokonane zmiany.
<F9>	Domyślne ustawienia konfiguracji – Wciśnięcie klawisza F9 powoduje wyświetlenie następującego okna: <pre>Setup Confirmation Load default configuration now? (Wczytać domyślną konfigurację?) [Yes] [No]</pre> <p>Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej (opcja »Yes“) i wciśnięciu klawisza Enter, wszystkie pola konfiguracji (Setup) zostaną ustawione na wartości domyślne. Po wybraniu odpowiedzi przeczącej (opcja »No“) i wciśnięciu klawisza Enter, lub wciśnięciu klawisza ESC, użytkownik powraca do miejsca, gdzie się znajdował przed wciśnięciem klawisza F9 bez wpływu na jakiegokolwiek istniejące wartości pól.</p>
<F10>	Zapisz i wyjdź – Wciśnięcie klawisza F10 powoduje wyświetlenie następującego komunikatu: <pre>Setup Confirmation Save Configuration changes and exit now? (Zapisać ustawienia i opuścić program?) [Yes] [No]</pre> <p>Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej (opcja »Yes“) i wciśnięciu klawisza Enter, zostają zapisane wszystkie zmiany oraz opuszczone okno konfiguracji. Po wybraniu odpowiedzi przeczącej (opcja »No“) i wciśnięciu klawisza Enter, lub wciśnięciu klawisza ESC, użytkownik powraca do miejsca, gdzie się znajdował przed wciśnięciem klawisza F10 bez wpływu na jakiegokolwiek istniejące wartości pól.</p>

Wyzerowanie pamięci CMOS

Jeżeli nie można uzyskać dostępu do menu konfiguracji pamięci BIOS, należy użyć zworki CMOS w celu wyzerowania konfiguracyjnej pamięci RAM.

1. Wyłączyć zasilanie systemu i odłączyć przewód zasilający.
2. Otworzyć obudowę serwera.
3. Wyjmij zworkę ze styków 1 i 2 (pozycja normalna) i załóż ją na styki 2 i 3 (kasowanie pamięci CMOS).
4. Zaczekaj od 5 do 10 sekund.
5. Przenieść zworkę z powrotem do pozycji normalnej (styki 1 i 2).
6. Zamknąć obudowę serwera.
7. Podłączyć przewód zasilający. Włączyć system.

Konfigurowanie systemu na potrzeby szeregowej magistrali RAID ATA

Konfigurowanie systemu BIOS

1. Upewnij się, że system jest wyposażony w co najmniej dwa dyski twarde SATA.
2. Uruchom tryb konfiguracji systemu BIOS, naciskając klawisz <F2> po rozpoczęciu testu pamięci POST.
3. Przejdź do opcji Advanced > IDE Configuration (Zaawansowane > Konfiguracja IDE); sprawdź, czy ustawiono parametr RAID opcji Configure SATA As (Skonfiguruj SATA jako). Tutaj można określić, jaka czynność ma być wykonywana po uruchomieniu: LSI i Intel® RAID. Jeśli to ustawienie zostanie wybrane, po włączeniu będzie uruchamiany program Intel® Matrix Storage Manager.
4. Zapisz ustawienia, naciskając klawisz <F10>.

Tworzenie zbioru RAID Intel® Matrix Storage Technology

UWAGA

Ta macierz RAID jest obsługiwana tylko w systemach operacyjnych Windows.

1. Po ponownym uruchomieniu na ekranie zostaje wyświetlony komunikat stanu opcji pamięci ROM menedżera Intel® Matrix Storage Manager. Naciśnij klawisze CTRL+I, aby uruchomić interfejs użytkownika opcji pamięci ROM aplikacji RAID.
2. W menu interfejsu użytkownika wybierz opcję nr 1: Create RAID Volume (Utwórz wolumin RAID). Wprowadź nazwę woluminu i naciśnij klawisz <Enter>. Nazwa woluminu RAID może zawierać wyłącznie angielskie alfanumeryczne znaki ASCII.
3. Używając klawiszy strzałek, wybierz pozycję RAID 0 lub RAID 1, a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
4. Wybierz napędy używane w systemie RAID (wyłącznie jeżeli w systemie są dostępne więcej niż dwa napędy), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
5. Wybierz rozmiar taśmy (wyłącznie dla RAID 0/5), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
6. Wprowadź rozmiar woluminu (w razie wybrania rozmiaru mniejszego od maksymalnego można później utworzyć drugą macierz RAID na pozostałej części woluminu), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
7. Na koniec naciśnij klawisz <Y>, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.
8. Zamknij interfejs użytkownika opcji pamięci ROM, naciskając klawisz <ESC>.

Tworzenie własnego zestawu RAID LSI Technology

UWAGA

Ta opcja jest włączana po uruchomieniu produktu.

1. Po ponownym uruchomieniu na ekranie zostaje wyświetlony komunikat stanu opcji pamięci ROM wbudowanej aplikacji RAID. Naciśnij klawisze CTRL+E, aby uruchomić interfejs użytkownika opcji pamięci ROM aplikacji RAID.
2. W menu zarządzania (Management Menu) wybierz opcję nr 1: „Configure”. Wybierz opcję „Easy Configuration”.
3. Zaznacz dyski, które mogą być używane w macierzy RAID, naciskając spację, a następnie naciśnij klawisz F10, aby zakończyć wybieranie.
4. Na ekranie „Select Configurable Arrays” naciśnij spację i klawisz <F10>.
5. Wprowadź właściwości nowej macierzy RAID: RAID Level (0/1/10), Size, Stripe Size. Zatwierdź ustawienia.
6. Zamknij ekran Easy Configuration, naciskając klawisz <ESC>, a następnie zapisz konfigurację.
7. Wróć do menu zarządzania (Management Menu) i włącz nową macierz RAID (Initialize).
8. Zamknij interfejs użytkownika opcji pamięci ROM, naciskając klawisz <ESC>.

Ładowanie sterowników RAID

1. Uruchom Instalatora systemu Microsoft® Windows® z dysku instalacyjnego CD-ROM systemu Microsoft® Windows®.
2. Po uruchomieniu instalatora naciśnij klawisz <F6>, aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy. Po wyświetleniu monitu włóż dyskietkę ze sterownikiem RAID. Zainstaluj odpowiedni sterownik kontrolera RAID SATA, „Kontroler Intel(R) ICH9R SATA RAID” w wypadku macierzy RAID Intel® Matrix Storage Technology lub „Intel Embedded Server RAID Technology” w wypadku zbioru RAID LSI Technology.
3. Zakończ instalację systemu Microsoft® Windows® i zainstaluj wszelkie niezbędne sterowniki.
4. Zainstaluj oprogramowanie do monitorowania, które znajduje się na dysku dołączonym do płyty głównej (można je także pobrać z Internetu): LSI MegaIDeSpy lub Intel® Matrix Storage Manager, w zależności od wybranej technologii RAID. Dzięki temu będzie można monitorować lokalnie konfigurację RAID. Błędy będą rejestrowane w lokalnych systemowych dziennikach błędów.

5 Informacje prawne i dotyczące zgodności

Zgodność prawna produktu

Zgodność produktu w zakresie bezpieczeństwa

Serwer spełnia wymagania następujących norm bezpieczeństwa:

- EN 60950 (Unia Europejska)
- CE – dyrektywa niskonapięciowa (ang. Low Voltage Directive) (73/23/EEC) (Unia Europejska)

Zgodność produktu z dyrektywą RoHS

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych: Ten system serwerowy jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/95/EC (RoHS).

Kompatybilność elektromagnetyczna produktu

Serwer został przetestowany i sprawdzony pod kątem zgodności z następującymi normami prawnymi dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej:

- EN55022 (Class A) – Radiated & Conducted Emissions (Unia Europejska) (Emisja radiacyjna i przenoszona)
- EN55024 (Odporność) (Unia Europejska)
- CE – dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (ang. EMC Directive) (89/336/EEC) (Unia Europejska)

Oznaczenia zgodności prawnej produktu

Niniejszy produkt posiada oznaczenie następujących świadectw zgodności produktu:

Tabela 7. Oznaczenia świadectw zgodności produktu

Oznaczenie CE	
---------------	---

Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Europa (Deklaracja zgodności CE)

Niniejszy produkt został przetestowany w zgodności z, oraz jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową (73/23/EEC) oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EEC). Produkt został oznaczony znakiem CE w celu zaświadczenia o jego zgodności z normami.